

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

回次	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
決算年月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月
売上高（百万円）	68,885	86,160	91,618	53,108	61,730
経常利益（百万円）	14,410	19,667	18,564	1,460	4,560
当期純利益（百万円）	8,230	10,936	11,112	251	2,470
純資産額（百万円）	70,276	81,823	89,665	86,328	88,091
総資産額（百万円）	99,318	113,791	118,603	123,925	124,313
1株当たり純資産額（円）	2,091.66	2,393.27	2,620.56	2,552.54	2,599.69
1株当たり当期純利益金額（円）	252.82	322.32	327.07	7.41	73.51
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額（円）	251.85	321.22	326.27	7.40	72.19
自己資本比率（％）	70.8	71.5	75.0	69.2	70.3
自己資本利益率（％）	13.1	14.4	13.1	0.3	2.9
株価収益率（倍）	30.6	22.3	13.1	328.6	78.2
営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）	12,322	13,194	9,296	4,605	11,017
投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）	△4,409	△8,952	△11,825	△13,586	△13,950
財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）	△3,031	△2,428	△3,180	24,363	△15,411
現金及び現金同等物の期末残高（百万円）	22,003	24,045	18,062	33,418	15,247
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕（人）	1,721 〔692〕	2,012 〔794〕	2,260 〔900〕	2,438 〔1,044〕	2,465 〔1,010〕

(注) 1. 売上高は消費税等抜きで表示しております。

2. 第68期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
決算年月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月
売上高 (百万円)	55,668	70,832	73,485	40,458	49,856
経常利益 (百万円)	13,329	19,038	16,289	225	3,017
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	8,272	10,761	9,976	△344	1,677
資本金 (百万円)	13,412	14,485	14,517	14,517	14,517
発行済株式総数 (千株)	33,562	33,982	33,995	34,004	34,004
純資産額 (百万円)	67,265	77,695	84,907	82,124	83,319
総資産額 (百万円)	91,727	104,162	110,141	117,449	116,746
1株当たり純資産額 (円)	2,001.92	2,285.02	2,495.85	2,431.31	2,461.69
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) (円)	50 (15)	75 (30)	79 (35)	20 (10)	20 (10)
1株当たり当期純利益金額又は1株 当たり当期純損失金額 (△) (円)	254.14	317.18	293.65	△10.15	49.93
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 金額 (円)	253.17	316.10	292.92	-	49.03
自己資本比率 (%)	73.3	74.5	76.9	69.6	70.9
自己資本利益率 (%)	13.7	14.9	12.3	-	2.0
株価収益率 (倍)	30.5	22.7	14.6	-	115.2
配当性向 (%)	19.7	23.6	26.9	-	40.1
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 (人)	1,259 〔598〕	1,319 〔663〕	1,498 〔778〕	1,641 〔914〕	1,661 〔884〕

(注) 1. 売上高は消費税等抜きで表示しております。

2. 第68期の1株当たり配当額には、創立記念70周年記念配当10円を含んでおります。

3. 第68期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

4. 第70期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

5. 第70期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。

## 2 【沿革】

年月	事項
昭和12年 5月	工業用砥石を製造、販売する目的で第一製砥所(個人営業)を創業。
昭和15年 3月	組織を有限会社第一製砥所に変更(設立)。
昭和33年11月	有限会社第一製砥所を株式会社第一製砥所に改組。
昭和44年12月	米国販売拠点として、DISCO ABRASIVE SYSTEMS, INC. (現 DISCO HI-TEC AMERICA, INC.) を設立。 (現 連結子会社)
昭和45年 2月	株式会社精密切断研究所(現 株式会社テクニスコ)を設立。(現 連結子会社)
昭和45年 9月	精密切断装置を開発、販売を開始。
昭和50年 2月	半導体用ダイシングソーを開発、販売を開始。精密ダイヤモンド工具へ進出。
昭和52年 4月	「株式会社ディスコ」に商号変更。
昭和54年 2月	東南アジア販売拠点としてシンガポール駐在員事務所(現 DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTD)を開設。 (現 連結子会社)
昭和54年 9月	欧州販売拠点として、Helmut Seier氏との共同出資によるDISCO SEIER AGをスイスに設立。
昭和55年 1月	精密平面研削装置を開発、販売を開始。
昭和57年 3月	DISCO DEUTSCHLAND GmbH (現 DISCO HI-TEC EUROPE GmbH) を設立。(現 連結子会社)
昭和58年 1月	株式会社ディスコ技研(後の株式会社ディスコ エンジニアリング サービス)設立。
昭和58年12月	本社を東京都大田区に移転し、隣接地に研究開発拠点として本社工場を新設。
昭和59年 3月	産業用ダイヤモンド工具へ進出。
昭和60年11月	株式会社ディスコ エンジニアリング サービスに、保守・サービス業務を移管。
昭和63年 2月	システム応用技術力の強化のため、株式会社ディー エス ディー (現 連結子会社) に資本参加。
平成元年10月	社団法人日本証券業協会より店頭売買銘柄としての登録承認を受け、株式を公開。
平成 2年12月	DISCO HI-TEC EUROPE GmbHを当社100%子会社とし、欧州販売拠点をスイスから移転。
平成 6年11月	国際標準化機構が定める品質システムISO9002を精密ダイヤ製造部門で取得。
平成 7年 8月	国際標準化機構が定める品質システムISO9001をP S事業部 (現 全拠点に該当) で取得。
平成 8年 4月	中国サービス拠点として上海駐在員事務所(現 DISCO TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO., LTD.)を開設。 (現 連結子会社)
平成 8年12月	韓国の合弁会社 DD Diamond Corporationが本格操業を開始。(現 連結子会社)
平成10年 2月	国際標準化機構が定める環境マネジメントシステムISO14001を広島事業所(呉工場および桑畑工場)で取得。
平成11年12月	東京証券取引所市場第一部に株式を上場。
平成13年10月	産業用ダイヤモンド工具部門を分社化し、株式会社ディスコ アブレイシブ システムズとして設立。(現 連結子会社)
平成14年 8月	精密切断装置としてレーザソーを開発、販売を開始。
平成16年11月	本社および研究開発拠点を東京都大田区大森北に新設し、移転。
平成17年 1月	株式会社ディスコ エンジニアリング サービスを吸収合併。
平成18年 8月	株式会社ダイイチコンポーネッツを設立。(現 連結子会社)
平成18年 8月	国際標準化機構が定める環境マネジメントシステムISO14001を国内全拠点で取得。
平成19年 8月	台湾販売拠点として DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD. を設立。(現 連結子会社)
平成20年12月	英国規格協会が定める事業継続マネジメントシステムBS25999-2を本社および広島事業所 (呉工場および桑畑工場) で取得。

### 3 【事業の内容】

当社グループ（当社および当社の関係会社）は当社および子会社20社、関連会社3社により構成されており、事業は、半導体製造装置、精密切断装置等の製造・販売を主に、これらに附帯する保守・サービス等を行っているほか、精密電子部品等の加工・販売、研削切断工具の製造・販売、コンピュータシステムのソフト・ハードの開発・販売を営んでおります。

事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりであります。

なお、次の3部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

区分		主要製品	主要な会社
電子業界関連 製品事業	半導体製造装置、 精密切断装置等の 製造・販売	〔精密加工装置〕 ダイシングソー レーザー グラインダ ポリッシャ ドライエッチャ サーフェースプレーナー  〔精密加工ツール〕 ダイシングブレード グラインディングホイール ドライポリッシングホイール	製造 当社 他 2社 販売 当社 DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U. K. LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD. 他 1社
	精密電子部品等の 製造・加工・販売	精密電子部品等	(株)テクニスコ (株)ダイイチコンポーネンツ 他 1社
	上記の装置等に係る 保守・サービス	—————	当社 DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U. K. LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD. 他 2社
産業用研削 製品事業	研削切断工具の 製造・販売	ダイヤモンドホイール 研削切断砥石等	製造 (株)ディスコ アブレイシブ システムズ DD Diamond Corporation 販売 (株)ディスコ アブレイシブ システムズ DD Diamond Corporation 他 1社
その他事業	コンピュータシステ ムのソフト・ハード の開発・販売他	—————	(株)ディーエスディー 他 3社



#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は出資金	事業内容	議決権の所有割合(%)	関係内容				
					役員の兼任等有無	資金援助(百万円)	営業上の取引	設備の賃貸借等	業務提携等
(連結子会社) ㈱テクニスコ	東京都品川区	499百万円	電子部品の製造、加工および販売	95.3	有	1,244	電子部品等の仕入先	備品の賃貸	なし
㈱ディスコ アブレイシブシステムズ	東京都品川区	490百万円	産業ダイヤモンド工具、一般砥石の開発、製造および販売	100.0	有	190	当社製品の販売および同社製品の仕入先	建物・設備・備品の賃貸	なし
㈱ダイイチコンポーネンツ	東京都大田区	20百万円	電動機、発電機、静止形電源装置、自動制御機器等電気機械器具の製造および販売	100.0	有	300	電子部品等の仕入先	建物・設備・備品の賃貸	なし
DISCO HI-TEC AMERICA, INC.	アメリカ合衆国	1,000千米ドル	当社製造の半導体製造装置等の販売および保守点検	100.0	有	387	当社製品の販売先	なし	なし
DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD	シンガポール国	900千シンガポールドル	当社製造の半導体製造装置等の販売および保守点検	100.0	有	—	当社製品の販売先	なし	なし
DISCO HI-TEC EUROPE GmbH	ドイツ国	1,278千ユーロ	当社製造の半導体製造装置等の販売および保守点検	100.0	有	—	当社製品の販売先	なし	なし
DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.	中国	8,000千米ドル	当社製造の半導体製造装置等の販売および保守点検	100.0	有	—	当社製品の販売先	なし	なし
DD Diamond Corporation	韓国	6,000百万ウォン	産業ダイヤモンド工具の開発、製造および販売	95.0	有	200	なし	なし	なし
その他10社									
(持分法適用関連会社) DHK Solution Corporation	韓国	1,000百万ウォン	当社製造の半導体製造装置の販売および保守点検	30.0	有	—	当社製品の販売先	なし	なし

(注) 1. 上記子会社のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

2. 資金援助欄の金額は上記子会社に対する貸付金であります。

3. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. は、平成22年4月1日付で DISCO HI-TEC CHINA CO., LTD. に社名変更しております。

4. DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTDについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

なお、DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTDの主要な損益情報等は次のとおりであります。

(1) 売上高	7,502百万円
(2) 経常利益	1,010百万円
(3) 当期純利益	852百万円
(4) 純資産額	3,172百万円
(5) 総資産額	4,717百万円

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成22年3月31日現在

事業の種類別セグメントの名称	従業員数(人)
電子業界関連製品事業	2,162 [855]
産業用研削製品事業	80 [72]
その他事業	32 [6]
全社（共通）	191 [77]
合計	2,465 [1,010]

- (注) 1. 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 臨時従業員数には、契約社員（嘱託、準社員およびパートタイマー等の臨時社員）を含み、人材会社からの派遣社員は除いております。
3. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

### (2) 提出会社の状況

平成22年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
1,661 [884]	36.5	10.8	5,332,926

- (注) 1. 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 臨時従業員数には、契約社員（嘱託、準社員およびパートタイマー等の臨時社員）を含み、人材会社からの派遣社員は除いております。
3. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

### (3) 労働組合の状況

当社では、現在労働組合は結成されておきませんが、労使関係は円満に推移しております。